

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關未來計劃詳情，請參閱「業務－戰略」。

所得款項用途

經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]以及其他估計開支後，我們獲得的[編纂]所得款項淨額如下：

	所得款項淨額（以百萬港元計）	
	(a) 假設[編纂] 未獲悉數行使	(b) 假設[編纂] 獲悉數行使
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的下限）.....	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的中位數）.....	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的上限）.....	[編纂]	[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數）及[編纂]未獲行使，基於我們的戰略，我們擬按下文所載用途及金額運用[編纂]所得款項：

- 約[70.0]%或[編纂]港元計劃在未來五年用於支持持續增長與提升我們的研發能力，專注於尖端芯片技術，包括：
 - (i). 約[40.0]%或[編纂]港元計劃在未來五年用於研發團隊的建設與人才保留，以及晶晨全球研發網絡的提升。具體分配如下：
 - (a). 約[15.0]%或[編纂]港元計劃用於加強我們在核心技術領域的研發人才儲備。我們重點招募及留任自主IP開發、全棧自研體系及架構創新領域的專家。特別是，我們致力推動全格式音視頻編解碼處理、超高清圖像處理、神經網絡、邊緣AI引擎與算法、芯片級安全解決方案、

未來計劃及所得款項用途

通信與無線連接芯片、物理AI及視覺系統等領域的核心IP迭代升級，構建強大、持續的技術壁壘。

此外，我們打算推進算法、軟件與系統設計的深度融合，夯實底層技術棧，建立通用技術加場景化定制的架構，實現核心技術多場景高效複用，顯著提升整體研發效率。

- (b). 約[25.0]%或[編纂]港元計劃用於擴充及保留通信與連接芯片及智能端側芯片領域的研發團隊。

具體包括：

- (A) 在通信與連接芯片領域，我們計劃開發覆蓋多種應用場景的芯片解決方案，包括高速光纖網關、FTTR全屋光網、車載光纖通信、Wi-Fi AP、Wi-Fi 6/7，以及支持4G和5G多模標準的集成多模芯片，從而構建一套全場景覆蓋的無線與有線融合連接系統。同時，我們致力於推進手機、智能穿戴設備與車載終端之間的跨設備協同，重點開發低延遲、高可靠的無線通信技術及協議棧。
- (B) 在智能端側芯片領域，我們專注於開發集成高性能處理單元的端側計算芯片與端側視覺處理芯片，以支持本地AI交互。我們致力於提供高度靈活、適應性強的端側智能芯片解決方案，滿足AIoT應用場景的多樣化需求，賦予終端設備智能感知、計算與決策能力，同時支持汽車智能座艙、各類服務機器人及其他AIoT服務等應用場景對實時高性能計算的需求。

我們計劃於未來五年招聘並留任合共約500名至560名研發人員，研發人員的平均複合年增長率將超過5%。截至2025年12月31日，我們共有1,684名研發人員。我們計劃在核心技術研發領域、通信與連接芯片領域及智能端側芯片領域分別招聘及留任約180名至200名、約100名至120名及約220名至240名研發人員。我們招聘及留任的人員將主要位於中國大陸。我們主要面向以下候選人：(i)擁有知名高校

未來計劃及所得款項用途

教育背景；(ii)具備電子工程、微電子與集成電路開發、算法、軟件開發等領域的專業知識；及(iii)中高級崗位要求具備三年以上行業經驗，初級崗位則面向應屆畢業生。我們預計，研發人員的年均薪資將介乎人民幣70萬元至人民幣85萬元。

- (ii). 約[30.0]%或[編纂]港元計劃用於依託晶晨全球研發網絡開發新一代芯片解決方案。我們計劃採購軟件、設備、材料及流片服務。具體而言：
 - (a). 約[10.0]%或[編纂]港元擬用於通過升級先進的EDA/IP軟件工具和設備來增強研發能力。我們旨在通過這些改進支持下一代通信與連接芯片、高性能智能端側芯片及核心技術的開發，提高產品開發效率，並增強我們在高端市場的技術壁壘和競爭力；及
 - (b). 約[20.0]%或[編纂]港元擬用於採購流片所必需的光罩及其他生產材料，同時支持原型開發和驗證，實現從產品設計到功能原型的無縫銜接。

具體而言，我們旨在每年推出10款或以上新款芯片產品，以於未來五年持續拓展我們的多場景應用能力。於未來五年，我們計劃合共申請超過200項專利及軟件版權，並完成多款採用6-nm及更先進制程節點的產品的流片工作。我們旨在加強在自研IP、通信與連接芯片及智能端側芯片等領域的技術深度，進而構建更具競爭力的產品組合。

- 約[10.0]%或[編纂]港元擬用於未來五年的全球客戶服務體系建設。通過我們的全球客戶服務網絡，我們旨在向關鍵國際客戶提供涵蓋產品引入、芯片適配到系統集成的全流程產品開發和技術服務。具體而言：
 - (i). 約[9.0]%或[編纂]港元計劃用於通過在全球範圍內招聘並留任客戶服務人員，加強我們的全球技術支持與客戶服務能力。我們計劃在全球範圍內招聘及留任合共80名至100名經驗豐富的產品銷售及營銷人員，年均薪資介乎人民幣850,000元至人民幣1,000,000元。憑藉我們位於中國內地、新加坡

未來計劃及所得款項用途

及韓國的現有辦事處，並擴大我們於歐洲及拉丁美洲的團隊，我們將為北美、歐洲、拉丁美洲以及亞洲高增長領域的核心客戶提供全面的銷售支持服務。

- (ii). 約[0.8]%或[編纂]港元計劃用於在未來五年內通過針對性銷售活動及參與行業展會，提升在新興市場的品牌知名度。
- (iii). 約[0.2]%或[編纂]港元計劃用於升級我們的數字化銷售管理系統及ERP平台。我們計劃拓展現有銷售管理系統的功能，以進一步提升對客戶需求的響應速度，及升級我們的ERP平台以提升供應鏈及整理運營效率。

通過構建全球客戶服務體系，我們旨在擴大直接客戶對接範圍、縮短技術支持平均響應時間，並持續提升客戶滿意度。這些運營優化舉措有望增強客戶忠誠度、提高客戶留存率，而這將對我們的長期運營效率及市場競爭力產生積極影響，最終助力提升市場滲透率並推動收入增長。

- 約[10.0]%或[編纂]港元擬用於推進「平台+生態」戰略的戰略投資與收購。我們計劃聚焦與我們業務具備強協同效應的目標，包括(i)在通信與連接芯片領域擁有核心IP或關鍵技術，(ii)含有可增強我們系統級解決方案的互補產品線，(iii)研發人員佔總員工人數比例較高的企業，及(iv)展現初步商業吸引力，例如年收入高達20百萬美元且增長潛力明顯。根據弗若斯特沙利文的數據，市場上有充足的符合我們選擇標準的目標。我們旨在通過投資及／或收購，融合互補技術能力、知識產權組合、產品方案、供應鏈體系及客戶基礎，助力擴充技術棧、拓展關鍵市場版圖，強化「平台+生態」戰略下的整體協同效應與競爭力。

我們計劃於未來五年內開展一至兩起戰略性收購，目標估值介乎人民幣50百萬元至人民幣500百萬元。我們計劃收購目標公司的多數股權，並將擁有資深半導體管理團隊的目標列為優先收購對象。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的投資收購目標。

未來計劃及所得款項用途

- 約[10.0]%或[編纂]港元將用作一般營運資金及一般公司用途。

若[編纂]設定為[編纂]範圍的上限或下限（假設[編纂]未獲行使），所得款項淨額將增加或減少約[編纂]港元（經扣除[編纂]相關[編纂]費用及開支）。我們擬按比例增加或減少用於上述用途的所得款項淨額。

若[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數），並經扣除應付[編纂]費用及佣金，我們將收取所得款項淨額約[編纂]港元。額外募集款項將按比例用於上述所得款項用途。

若[編纂]所得款項淨額未立即用於上述用途，我們僅將其存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構（定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區適用法律法規）的短期計息賬戶。若上述擬定所得款項用途有任何變動，我們將適時發佈公告。